

ThinkSystem SD530 及 D2 機櫃

隨時隨地敏捷應變



可因應後續發展

Lenovo ThinkSystem SD530 這個單一平台，設計不僅著重於關鍵企業工作負荷環境（例如，虛擬化、高度融合基礎架構及雲端），同時也具備高效能運算（HPC）及人工智慧（AI）。將刀鋒的效率及密度與機架型伺服器的價值和簡易操作性整合，SD530 可能是全世界最敏捷應變的伺服器。

ThinkSystem SD530 包含模組化 2U Lenovo D2 機櫃，其中具有四個前端存取取用的 SD530 伺服器（節點）。每個節點都會整合兩個第二代 Intel® Xeon® Processor Scalable 系列 CPU，而能比第一代產品提升高達 36% 的效能。*

D2 機櫃的創新設計都能在現代資料中心內靈活地符合各種需求。例如，多個 D2 機櫃都能輕鬆地串連在一起，然後再以單一單位進行管理，其中可降低高達 92% 的佈線成本（與舊版*相較之下）以及簡化管理。

超密集、超敏捷

今日的 IT 管理員都被要求以更少投資取得更大回報。SD530 會針對傳統的 1U 伺服器的每 U 處理兩倍工作負荷。在單一 42U 機架中，您可以利用下列項目裝載多達 76 個伺服器：多達 152 個處理器、4,256 個核心、77.8TB 的記憶體和 3.6PB 的儲存空間。†與舊版*相較之下，SD530 可針對每 U 提供超過 32 個核心，同時還能維持每個節點多達 6 個 SFF 磁碟機和多達兩個直接連接 NVMe SSD - 所有元件都能容納在符合業界標準的機架中。

對於需要大量本機儲存設備的軟體定義儲存設備及高度融合工作負荷，SD530 可提供理想的儲存密度及能力。對於 U.2 SSD 的支援可提供重要效能，以符合日益增加的業務需求。與今日所用 SATA DOM 解決方案相較下，內部 M.2 開機磁碟機可提供更多容量和更高的可靠性。

最大運算能力

SD530 設計旨在執行最高核心 Intel® Xeon® Platinum 處理器，透過您要求最嚴苛的 HPC 或 AI 工作負荷提供動力。隨著許多使用案例（包含 VDI、HPC 及 Machine Learning）對於 GPU 技術的要求持續增加，SD530 支援各種 GPU - 包含最新的 NVIDIA Tesla V100。創新的 D2 機櫃可裝入選用的 1U 匣，而且每個節點可支援兩個 GPU 或加速器（每個 D2 機櫃最多兩個匣）。

Lenovo

2 | ThinkSystem SD530 及 D2 機櫃

其他記憶體及儲存技術增強功能可在任何環境中提供出色效能和彈性：

- 與舊版 2U/4 節點平台* 相較之下，提升 50% 的記憶體通道及能力，其中可增加 11% 的記憶體速度*
- 舊版產品的兩倍 SAS 頻寬，且可支援 12Gb SAS
- 高度融合環境的舊版平台的兩倍儲存容量



SD530 提供刀鋒密度和機架系統的經濟效益。

轉型敏捷應變性

藉由利用專為著重於企業及 HPC 工作負荷而設計的單一平台，ThinkSystem SD530 可讓您使用常見元件及管理而縮短合格及測試時間，以及提升彈性。

這可透過 D2 機櫃加以實現。單位前端有多達四個節點，其為「熱切換式」設計而可徹底發揮正常執行時間。可移除個別節點，而不需要停機其餘的三個節點。每個 SD530 節點都包含處理器、記憶體和多達六個 2.5 吋儲存裝置。

D2 機櫃後端包含「梭動」及電源供應器、風扇、介面卡插槽和網路及管理連接埠。藉由從節點解開聚集介面卡插槽和 NIC (LOM 及 PCIe)，獨特的梭動設計提供最大的 I/O 彈性。

機櫃支援兩個梭動之一：

- x16 簡易切換式 PCIe 梭動，其中包含四個 PCIe x16 低高度介面卡插槽（每個節點一個）- 徹底發揮 I/O 效能
- x8 PCIe 梭動，其中包含八個 PCIe x8 低高度介面卡插槽（每個節點兩個）- 最大化介面卡插槽數量

兩個梭動均支援 10Gb Base-T、10Gb SFP+ 或非 LOM 選項，而可讓您僅安裝預算內最佳網路選項所需的 LOM/NIC。梭動支援各種高速互連光纖（包含適用於 HPC/AI 環境的 OmniPath 及 InfiniBand），以及適用於更傳統之企業及雲端環境的各種乙太網路和光纖通道記憶卡。

模組化菊鏈管理

除了 D2 機櫃以外，Lenovo 也提供適合進行菊鏈管理的模組化機櫃。模組化機櫃可減少 ToR 連接埠成本、纜線成本和降低機架複雜性。



與 D2 機櫃搭配使用的後端梭動改革設計，可為 SD530 超密集平台提供最大 I/O 彈性。



管理輕鬆

Lenovo XClarity Controller 是全新硬體內嵌的管理引擎（常見於每個 ThinkSystem 伺服器）。XClarity Controller 配備井然有序的圖形化使用者介面、符合業界標準的 Redfish 合規 REST API，而且可縮短前代伺服器一半開機的時間，而且可加速 6 倍韌體更新的時間。

D2 機動包含可擴充的管理模組 (SMM)，其可控制風扇及電源，而且可將每個節點的 XClarity Controller 整合到單一連接埠。與前版產品相較之，選用的雙連接埠 SMM 可讓機櫃的菊鏈作業降低高達 29% 的佈線成本和複雜性。 **

Lenovo XClarity Administrator 是可集中管理 ThinkSystem 伺服器、儲存設備及網路的虛擬化應用程式。透過可重複使用的樣式及原則，其可迅速達到和擴充基礎架構佈建和維護。其可作為中央整合點，而可將您的資料中心管理程序擴充到實體 IT。在外部 IT 應用程式中執行 XClarity Integrators 或是透過 REST API 整合，協助您進一步加速服務佈建、串流 IT 管理和節省成本。

Lenovo 伺服器持續成為業界領先最可靠[®]。

Lenovo 服務及安全性

Lenovo 服務支援投資的完整生命週期，是最適合 Lenovo 世界級產品的完美補強產品：Lenovo ThinkSystem 伺服器、儲存設備及網路產品：

作為全球數千家公司最受信賴的服務提供者，Lenovo 擁有專業知識及豐富經驗，而可協助從解決方案到部署、整合及移轉至主動管理服務的所有作業。

Lenovo 服務保證為您提供卓越的服務經驗，而且可透過 Lenovo 服務專業人員及 Lenovo 授權服務提供者網路提供。

關於 Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) 是資本額達 450 億美元的財星 500 大企業，同時也是推動智慧轉型的全球技術領導廠商。Lenovo 的資料中心解決方案 (ThinkSystem、ThinkAgile) 會創造出可改變企業和社會的容量和運算威力。

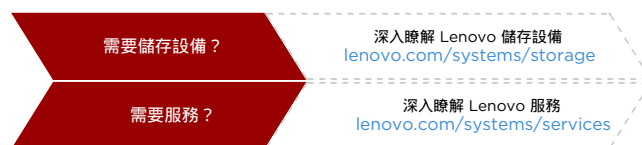


規格

外型尺寸/高度	2U 機架機櫃；4 個獨立運算節點
處理器	多達 2 個第二代 Intel® Xeon® Platinum 處理器，多達 205W
記憶體	16 個插槽中多達 2TB，其中會使用 128GB 3DS RDIMMs；2,933MHz TruDDR4
擴充插槽	每個 D2 機櫃 1 個梭動：x8 PCIe 梭動及 8 個 PCIe 3.0 x8 插槽（每個節點 2 個）；或是 x16 PCIe 梭動及 4 個 PCIe 3.0 x16 插槽（每個節點 1 個）。多達 2 個外部 1U 匣（每個節點各擁有多達 2 個 GPU）
磁碟機槽	多達 24 個（每個節點 6 個）熱抽換式 2.5 吋 SAS/SATA HDD/SSD；多達 16 個（每個節點 2 個）熱抽換式 2.5 吋 NVMe SSD
網路介面	選用的 8 連接埠 E10M 10Gb SFP+（每個節點 2 個連接埠）；選用的 8 連接埠 E10M 10Gb RJ45（每個節點 2 個連接埠）
電源供應器	2 個熱切換/備援 1+1 1600W/2000W；或是 1 個非備援 1100W
熱抽換式元件	電源供應器、風扇、SAS/SATA/NVMe 儲存裝置；運算節點是暖切換式
RAID 支援	SW RAID 支援 JBOD；Entry RAID；選用的 HW RAID 12Gb 支援 JBOD；加上 M.2 開機支援和選用的 RAID
系統管理	XClarity Controller 內嵌管理、XClarity Administrator 集中化基礎架構交付、XClarity Integrator 外掛程式及 XClarity Energy Manager 集中化伺服器電源
GPU 匣支援	GPU 匣支援一或兩個 GPU 記憶卡；每個 D2 機櫃最多兩個 GPU 匣
支援的作業系統	Microsoft、Red Hat、SUSE、VMware。請造訪 lenovopress.com/osig 以瞭解更多資料。
有限保固	3 年客戶可自行替換之零件服務與現場服務；下個營業日維修服務（每天 9 小時/每週 5 天），提供保固服務升級

如需詳細資訊

若要深入瞭解 Lenovo ThinkSystem SD530，請聯絡 Lenovo 業務代表或事業夥伴，或請造訪：www.lenovo.com/thinksystem。如需詳細規格，請參閱《SD530 產品指南》。



¥ 以 Intel 內部測試為依據，2018 年 8 月。 + 假設 4U 的機架已由網路或其他元件使用。與 Lenovo NeXtScale nx360 M5 相較之下。 § ITIC 2018 年全球可靠性報告。 ** Lenovo 建議將菊鏈的模組化機櫃數量限制為 7 個模組化機櫃。

© 2025 Lenovo.版權所有。

可用性：優惠、價格、規格和供應情況如有更改，恕不另行通知。Lenovo 不負責圖片或印刷上的錯誤。**保固：**若要獲得適用的保固文件副本，請洽：Lenovo Warranty Information, 1009 Think Place, Morrisville, NC, 27560。Lenovo 對協力廠商的產品或服務不做任何聲明或擔保。**商標：**Lenovo、Lenovo 標誌、Lenovo Services、Lenovo XClarity、NeXtScale、ThinkAgile、ThinkSystem 與 TruDDR4 是 Lenovo 的商標或註冊商標。Intel® 與 Xeon® 是 Intel Corporation 或其附屬公司在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。Microsoft® 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家或地區的商標。其他公司、產品或者服務名稱可能為其他公司的商標或服務標誌。文件編號 DS0003，發行 April 27, 2020。如需最新版本，請移至 lenovopress.lenovo.com/ds0003。

